



各 位

平成 30 年 4 月 25 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

固定資産の取得（工場新設）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、固定資産の取得（工場新設）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得（工場新設）の理由

当社は、尼崎の本社地区において、MEMS技術を用いたプローブカードの部品を生産しております。今後、今後のメモリーIC用プローブカードの市場拡大や更なる製品の高度化を見据え、生産能力の強化を図るため工場の新設を決議いたしました。

2. 取得資産の内容（予定）

(1) 名称	日本電子材料株式会社 三田工場（仮）
(2) 所在地	兵庫県三田市
(3) 敷地面積	3,332 m ²
(4) 延床面積	約 3,000 m ²
(5) 投資総額	約 34 億円
(6) 資金計画	自己資金及び借入金で充当
(7) 生産品目	半導体検査用部品（プローブカード）

3. 日程

生産開始は平成 32 年 1 月を予定しております。

4. 業績への影響

当該固定資産の取得により見込まれる諸費用は、主として将来的に発生するものであり、平成 30 年 3 月期の連結業績にあたえる影響は軽微であります。

以 上